

國立清華大學

碩士論文

晶片尺寸級無鉛焊點在不同焊墊表面處理
下的可靠度分析

**Reliability Analysis of Lead free CSP solder joint under
different surface finishing**

系 所：動力機械工程所 組 別：固力組

學 號：g923771

姓 名：張簡千琳 (Chien-Lin Chang Chien)

指導教授：葉銘泉 博士 (Dr. Ming-Chuen Yip)

中華民國九十四年六月